



TS-TIR®700-25系列 是一款高效碳基导热垫片，结合高导热碳纤维与高分子硅胶材料，以先进工艺精准分布导热通路，实现优异的热传导性能，有效降低界面热阻并提升散热效率。其具备超薄轻量 and 机械柔韧性，适用于5G设备、高性能芯片及其他高热通量应用。

特性

- 》良好的热传导率25W/mK
- 》极低热阻抗
- 》可在低压下工作
- 》非绝缘型材料，导电的
- 》无表面粘性

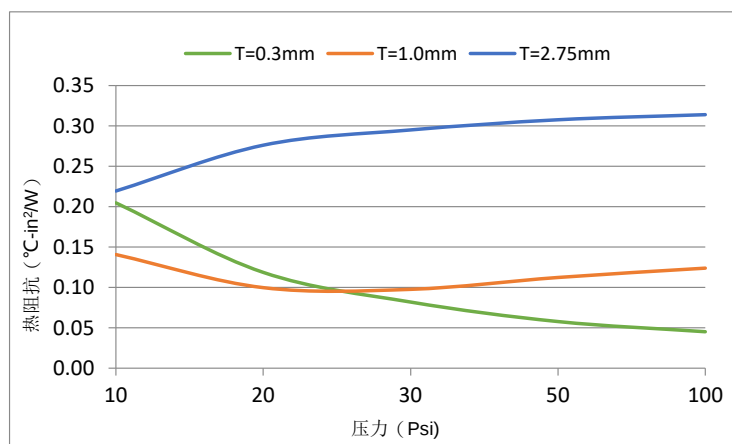
应用

- 》芯片与散热模组之间
- 》5G通讯设备
- 》光电行业
- 》可穿戴设备

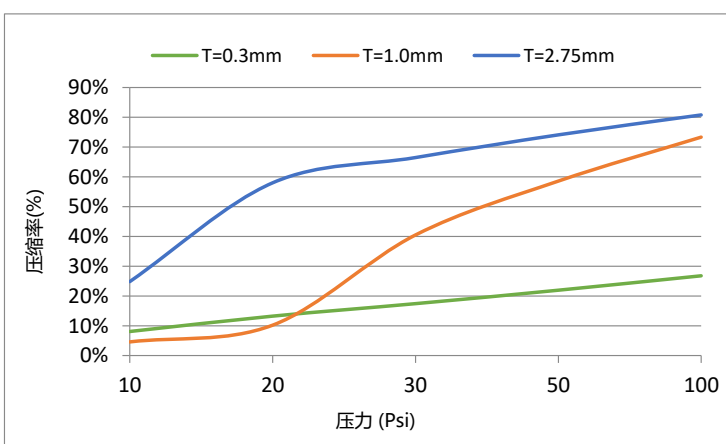
TS-TIR®700-25 系列碳基导热垫系列特性表

产品特性	典型值		测试标准
颜色	灰色		Visual
结构&成份	碳纤维填充硅橡胶		-
厚度范围	0.01"~0.04" (0.3~1.0mm)	0.06"~0.20" (1.5~5.0mm)	ASTM D374
硬度 Shore OO	75±10	55±10	ASTM D2240
密度 (g/cm³)	2.9		ASTM D792
建议使用温度范围 (°C)	-40~200		内部测试
导热系数 W/mK	25		ASTM D5470
比热容 J/(g·°C)	0.75		ASTM E1269 @25°C
阻燃等级	V-0		UL94
RoHS	符合		IEC62321

热阻抗



压缩率



产品规格

标准厚度: 0.01" (0.3mm), 0.02" (0.5mm), 0.04" (1.0mm), 0.06" (1.5mm), 0.08" (2.0mm), 0.10" (2.5mm), 0.12" (3.0mm)
标准尺寸: 1.97" × 1.97" (50.0mm × 50.0mm)

TIR®700-25系列产品可模切成不同形状提供。如需不同厚度请与本公司联系。如需更大尺寸，请与本公司联系。
欲了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

导热材料

发热材料

导热工程塑料

发泡硅胶

模切制品

加拿大 Canada
TEL: +001-604-2998559
E-mail: frances@ziitek.com.tw
<http://www.thermazig.com>

台湾 Taiwan
TEL: +886-2-22771007
E-mail: frances@ziitek.com.tw
<http://www.ziitek.com.tw>

东莞 Dongguan
TEL: +86-769-38801208
E-mail: frances@ziitek.com.cn
<http://www.ziitek.com.cn>

昆山 Kunshan
TEL: +86-512-57816297
E-mail: alex@ziitek.com
<http://www.ksziitek.com>

